

苏州国芯科技股份有限公司

关于自愿披露公司研发的高性能 AI MCU 芯片新产品内部 测试成功的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）研发的高性能AI MCU芯片新产品CCR7002于近日在公司内部测试中获得成功。现将相关事项公告如下：

一、新产品的基本情况

本次成功研发的芯片新产品CCR7002是公司与广东赛昉科技有限公司（以下简称“赛昉科技”）共同研发推出的高性能AI MCU芯片，采用多芯片封装技术集成了赛昉科技的高性能SoC芯片子系统与公司的AI芯片子系统，其中，高性能SoC芯片子系统搭载64位高性能四核RISC-V处理器，具有高性能、低功耗、高安全性的特点，工作频率最高可达1.5 GHz；AI芯片子系统采用32位低功耗RISC-V处理器，实时性强，集成了NPU神经网络处理单元，提供0.3TOPS算力支持，NPU神经网络处理单元集成了卷积、池化、激活函数等多种硬件加速算子，能够高效运行MobileNet、ResNet、EfficientNet、Yolo等深度学习算法，使设备能够实时完成物体识别、目标检测、图像分类等复杂任务，为更广泛的应用提供AI计算能力。

新产品CCR7002具有丰富的外部接口和多个的高速接口，如PCIE2.0、USB3.0、GMAC、SD3.0、CAN2.0、PWMT、ADC等，集成了AES、3DES、HASH、SM4、PKA和TRNG等安全引擎。CCR7002支持Linux操作系统，内部集成GPU，兼容主流摄像头传感器，支持H.264/H.265/JPEG编解码和4K@30fps显示。CCR7002芯片可以面向工业控制、能量控制、楼宇控制、智慧交通等领域实现应用。

二、对公司的影响

公司和赛昉科技共同拥有该芯片新产品的知识产权。本次新产品研发成功，丰富了公司 AI MCU 芯片产品线，完善了公司在 AI MCU 芯片产品领域的布局，提高了公司在该领域的竞争力，对公司未来业绩成长性预计将产生积极的影响。

三、风险提示

本次测试目前是公司内部测试成功，尚未完成第三方机构检测测试。本次公司推出的高性能 AI MCU 芯片新产品 CCR7002 在后期的客户使用中不排除存在发现问题的可能性，将对公司收入及盈利带来不确定性，公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司

董事会

2024年11月25日